# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-31470 (P2003-31470A)

(43)公開日 平成15年1月31日(2003.1.31)

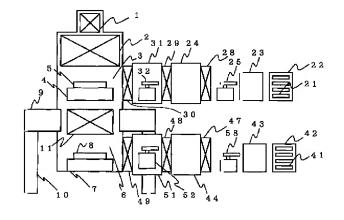
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		<b>微别</b> 記号	FΙ		テーマコート*( <b>参考)</b>			
H01L	21/027		C03F	7/20		504	2H097	
G03F	7/20	504				506	5 C O 3 4	
		5 0 6	H 0 1 J	37/305		В	5 F 0 4 6	
H 0 1 J	37/305		H01L	21/30		541S	5 F O 5 6	
						502P		
		審查請求	未請求請求	成項の数11	OL	(全 7 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願2001-214793( P2001-214793)	(71)出願	(71)出願人 000004112				
				株式会	社二コ.	ン		
(22)出顧日		平成13年7月16日(2001.7.16)		東京都	千代田	区丸の内3 厂	目2番3号	
			(72)発明	者 鈴木	素子			
				東京都	千代田	区丸の内3丁	目2番3号 株	
				式会社、	ニコン	内		
			(72)発明	者 平柳 ?	徳行			
				東京都	千代田	区丸の内3丁	目2番3号 株	
			式会社ニコン内					
			Fターム(参考) 2H097 CA16 GB00 LA10					
			5C034 BB05					
				5F0	046 AA	25 DA06 DA26		
				5F0	056 BA	10 CB40 EA04	EA12	

# (54) 【発明の名称】 露光装置

#### (57)【要約】 (修正有)

【課題】真空下で露光を行う露光装置において、高スループットかつ高精度で転写露光を行うのに好適な露光装置を提供する。

【解決手段】レチクル及びウエハが、大気圧状態の雰囲気から真空領域に搬送される時の断熱膨張による温度変化をレチクル及びウエハに熱を加えることにより補償する手段を具備した。また、前記補償する手段が、真空排気を開始する前に、予め推測した断熱膨張によるレティクルの温度低下をほば相殺する量の熱をレティクルに加え始めるように設定されている露光シーケンスプログラムを含むものである。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】真空中にてレチクル上のパターンをウエハ に転写露光する露光装置において、断熱膨張による前記 レチクルの温度変化を補償する手段を具備したことを特 徴とする露光装置。

【請求項2】前記補償する手段が、真空排気を開始する前に、予め推測した断熱膨張によるレチクルの温度低下をほぼ相殺する量の熱をレチクルに加え始めるように設定されている露光シーケンスプログラムを含むものであることを特徴とする請求項1に記載の露光装置。

【請求項3】前記補償する手段が、所定の温度に制御された部材を前記レチクルに接触させることにより加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項1または2に記載の露光装置。

【請求項4】前記補償する手段が、ランプからの輻射熱により加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項1または2に記載の露光装置。

【請求項5】真空中にてレチクル上のパターンをウエハ に転写露光する露光装置において、断熱膨張による前記 ウエハの温度変化を補償する手段及び温度変化を補償した後に前記ウエハの温度を微調整するための温度安定化手段を具備したことを特徴とする露光装置。

【請求項6】前記補償する手段が、真空排気を開始する前に、予め推測した断熱膨張によるウエハの温度低下をほぼ相殺する量の熱をウエハに加え始めるように設定されている露光シーケンスプログラムを含むものであることを特徴とする請求項5に記載の露光装置。

【請求項7】前記温度安定化手段が、ウエハを接触させることにより温度を安定化させる、所定の温度に設定した恒温部材であることを特徴とする請求項5に記載の露光装置。

【請求項8】前記補償する手段が、加熱ランプからの輻射熱により加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項5または6に記載の露光装置。

【請求項9】前記補償する手段が、所定の温度に制御された部材を前記ウエハに接触させることにより加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項5または6に記載の露光装置。

【請求項10】前記恒温部材が、ヒータとペルチェ素子 と温度計測センサを用いたフィードバック制御系を構成 しているものであることを特徴とする請求項7に記載の 露光装置。

【請求項11】前記恒温部材が、ランプと温度計測センサを用いたフィードバック制御系を構成しているものであることを特徴とする請求項7に記載の露光装置。

#### 【発明の詳細な説明】

# 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体デバイスの 製造に用いられる露光装置に関する。特に、電子線やイ オンビーム等のエネルギー線を用い、真空下で露光を行 う露光装置に関するものであって、高スループットかつ 高精度で露光を行うのに好適な露光装置に関するもので ある。

## [0002]

【従来の技術】電子線転写露光装置のように、真空雰囲気下で露光を行う場合、転写を行うレチクル及びウエハは、最初の段階では、大気圧下に置かれている。露光するためには、先ず、このレチクル及びウエハを露光装置の真空領域内に搬送する必要があるが、直接、大気圧雰囲気から露光装置の真空領域に搬送することは少ない。通常、露光装置には、ロードロック室と呼ばれる室が備えられており、先ず、そこにレチクル及びウエハを搬入する。ロードロック室には、真空ポンプが敷設されており、室内を真空に引くことが出きる。ロードロック室では、大気圧下でレチクル及びウエハを受け入れ、室内を真空に引いた後、露光装置との間の扉を開いて、真空下でレチクル及びウエハのやり取りを行う。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ロードロック室で真空 排気する時には、気体の断熱膨張により、室内の温度が 低下する。低下する温度は、室内の容積、ロードロック 室の熱容量等によって異なるが、室内容積が数十リット ル程度のものの場合、2~4℃程度低下する。これに伴 い、ロードロック室内のレチクル及びウエハの温度も同 様に低下する。露光装置は通常、温調配管により、所定 の温度に保たれるようになっているが、断熱膨張により 冷却されたレチクル及びウエハの温度が再び回復して、 元の温度になるまでには、数十分が必要である。そのた め、その間ロードロック室または、露光装置内にレチク ル及びウエハを置いた状態で露光開始を待たなければな らない。温度が低下した状態では、レチクルは全体に縮 み、パターンには歪みが生じており、ウエハも同様に全 体的に縮んでいるため、この状態で露光すると、転写パ ターンの寸法精度を保証できないからである。

【0004】このように、ウエハの温度安定のための待ち時間が必要であったため、真空中で露光する露光装置のスループットは非常に低くなっていた。本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、電子線やイオンビーム等のエネルギ線を用い、真空下で露光を行う露光装置において、高スループットかつ高精度で転写露光を行うのに好適な露光装置を提供することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明の露光装置は、第一に「真空中にてレチクル上のパターンをウエハに転写露光する露光装置において、断熱膨張による前記レチクルの温度変化を補償する手段を具備したことを特徴とする露光装置。(請求項1)」を提供する。これにより、断熱膨張によるレチクルの温度低下が著しく少なくなるため、レチクルがレチクルステージチャンバに搬送されてからの温度が安定す

るまでの時間が非常に短くなり、高スループットで転写 露光ができ、同時に、高精度で転写露光することができ る露光装置を提供することができる。

【0006】また、本発明では第二に「前記補償する手段が、真空排気を開始する前に、子め推測した断熱膨張によるレチクルの温度低下をほぼ相殺する量の熱をレチクルに加え始めるように設定されている露光シーケンスプログラムを含むものであることを特徴とする請求項1に記載の露光装置。(請求項2)」を提供する。これにより、断熱膨張によるレチクルの温度低下をほぼ相殺することができるようになり、レチクルがレチクルステージチャンバに搬送されてからの温度が安定するまでの時間が非常に短くすることができる。

【0007】また、本発明では第三に「前記補償する手段が、所定の温度に制御された部材を前記レチクルに接触させることにより加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項1または2に記載の露光装置。(請求項3)」を提供する。これにより、簡単な手段で、レチクルに効果的に熱を伝えることができる。

【0008】また、本発明では第四に「前記補償する手段が、ランプからの輻射熱により加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項1または2に記載の露光装置。(請求項4)」を提供する。これにより、簡単な手段で、レチクルに効果的に熱を伝えることができる。

【0009】また、本発明では第五に「真空中にてレチクル上のパターンをウエハに転写露光する露光装置において、断熱膨張による前記ウエハの温度変化を補償する手段及び温度変化を補償した後に前記ウエハの温度を微調整するための温度安定化手段を具備したことを特徴とする露光装置。(請求項5)」を提供する。これにより、真空断熱によるウエハの温度低下が著しく少なくなるため、ウエハがウエハステージチャンバに搬送されてからの温度が安定するまでの時間が非常に短くなり、高スループットで転写露光ができ、同時に、高精度で転写露光することができる露光装置を提供することができる。

【0010】また、本発明では第六に「前記補償する手段が、真空排気を開始する前に、予め推測した断熱膨張によるウエハの温度低下をほぼ相殺する量の熱をウエハに加え始めるように設定されている露光シーケンスプログラムを含むものであることを特徴とする請求項5に記載の露光装置。(請求項6)」を提供する。これにより、断熱膨張によるウエハの温度低下をほぼ相殺することができるようになり、ウエハがウエハステージチャンバに搬送されてからの温度が安定するまでの時間が非常に短くすることができる。

【0011】また、本発明では第七に「前記温度安定化手段が、ウエハを接触させることにより温度を安定化させる、所定の温度に設定した恒温部材であることを特徴とする請求項5に記載の露光装置。(請求項7)」を提供する。これにより、ウエハの温度を精密に制御すること

ができ、高スループットかつ高精度の露光装置を提供できる

【0012】また、本発明では第八に「前記補償する手段が、加熱ランプからの輻射熱により加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項5または6に記載の露光装置。(請求項8)」を提供する。これにより、簡単な手段で、ウエハに効果的に熱を伝えることができる。

【0013】また、本発明では第九に「前記補償する手段が、所定の温度に制御された部材を前記ウエハに接触させることにより加熱する加熱手段であることを特徴とする請求項5または6に記載の露光装置。(請求項9)」を提供する。これにより、簡単な手段で、ウエハに効果的に熱を伝えることができる。

【0014】また、本発明では第十に「前記恒温部材が、ヒータとペルチェ素子と温度計測センサを用いたフィードバック制御系を構成しているものであることを特徴とする請求項7に記載の露光装置。(請求項10)」を提供する。これにより、ウエハの温度を精密に制御することができ、高スループットかつ高精度の露光装置を提供できる。

【0015】また、本発明では第十一に「前記恒温部材が、ランプと温度計測センサを用いたフィードバック制御系を構成しているものであることを特徴とする請求項7に記載の露光装置。(請求項11)」を提供する。これにより、ウエハの温度を精密に制御することができ、高スループットかつ高精度の露光装置を提供できる。

#### 【0016】

【実施例】本発明の露光装置の実施の形態を以下に説明するが、本発明はこの例のみに限定されるものではない。図1は本発明による露光装置の全体の概略を示す図である。図2は本発明によるレチクルローダ系を示す図である。図3は本発明によるウエハローダ系を示す図である。以下に、図1~3を用いて本発明の実施の形態を説明する。

【0017】先ず、図1を用いて、本発明による装置の本体 部概略構成について説明する。本露光装置は、電子銃1 と照明電子光学系2とを備えており、照明電子光学系2 の下方には、レチクルステージチャンバ3が設けられて いる。レチクルステージチャンバ3内には、レチクルス テージ4が配置され、その上にはレチクルホルダ5が取 りつけられている。レチクルステージチャンバ3の下方 には、投影電子光学系11が配置され、その更に下方に は、ウエハステージチャンバ6が設けられている。 ウエ ハステージチャンバ6には、ウエハステージ7が配置さ れ、その上にはウエハホルダ8が取りつけられている。 これらの部材はメインボディ9により自重を保持される ようになっており、メインボディ9に取りつけられた脚 10により、床上に立脚している。装置の各部には温調 配管(図示せず)が取りつけられており、所定の温度に なるように制御されている。

【0018】次に本発明による装置のレチクルローダ系第1 の構成について図1、図2(a)、(b)を利用して説 明する。レチクル21は複数枚がまとまってレチクルカ セット22に収まっている。レチクルカセット22の近 傍には、レチクル大気圧ロボットアーム25、レチクル プリアライナ23、レチクルロードロック室24とが設 置されている。レチクルロードロック室24内には、ヒ ータ付き保温部材27が配置されている。このヒータ付 き保温部材27は、金属からなり、比熱の大きな物質が 好適である。また、このヒータ付き保温部材27は、オ ープン制御によって、温度を制御されている。ロードロ ック室24は、ゲートバルブa28、ゲートバルブb2 9が設けられており、開閉自在となっている。レチクル 真空ロードチャンバ31の中には、真空ロボットアーム 32が設置されている。また、レチクル真空ロードチャ ンバ31には、ゲートバルブb29、ゲートバルブc3 Oが取り付けられており、開閉自在となっている。

【0019】次に本発明による装置のレチクルローダ系第2の構成について図2(a)、図2(c)を利用して説明する。図2(c)はロードロック室24内の構成を代えたものを示している。レチクルローダ系第1の構成では、ロードロック室24の内部は図2(b)に示すものでであったが、第2の構成ではこれに代わって図2

(c)に示す構成となっている。ロードロック室24の内部には、ホルダ34が設置されており、その上方にランプ26が配置されるようになっている。また、上記レチクルローダ系第2の構成では、ランプ26はホルダ34の上方に設置されていたが、レチクル21の下面を照射するように、ランプ26をホルダ34の下方に配置しても良い。他の部分の構成はレチクルローダ系第1の構成の場合と全く同じである。

【0020】次に本発明による装置のウエハローダ系第1の構成について図1、図3(a)、(b)、(d)を用いて説明する。ウエハ41は複数枚がまとまってウエハカセット42に収まっている。ウエハカセット42の近傍には、大気圧ロボットアーム58とウエハプリアライナa43とウエハロードロック室44が設置されている。ウエハロードロック室44内には、ウエハ41を置くヒータ付き保温部材59が配置されており、所定の温度に保たれている。

【0021】ウエハロードロック室44はゲートバルブd47、ゲートバルブe48が設けられている。ゲートバルブe48の一端はウエハ真空ロードチャンバ51に取りつけられており、ウエハ真空ロードチャンバ51内には、ウエハ真空ロボットアーム52が設けられている。ウエハ真空ロードチャンバ51には、ゲートバルブe48のほか、ゲートバルブf49とゲートバルブg50が取りつけられている。ゲートバルブg50の他端はウエハプリアライナb53に接続されている。ウエハプリアライナb53内には、恒温部材54が配置されている。

恒温部材54には、ヒータ55、ペルチェ素子56、温度計測センサ57とが設けられており、所定の設定温度から±0.1℃の範囲に収まるように制御するため、温度センサ57の出力をフィードバックすることにより、温度制御を行っている。温度を上昇させるためには、ヒータ55を用い、逆に温度を下降させるためには、ペルチェ素子56を用いて温度制御を行う。これにより、恒温部材54に接触するウエハ41の精密な温度管理が可能となる。

【0022】次に本発明による装置のウエハローダ系第2の構成について図3(a)、(c)を利用して説明する。図3(c)はウエハロードロック室44内の構成を代えたものを示している。ウエハローダ系第1の構成では、ウエハロードロック室44の内部は図3(b)に示すものでであったが、第2の構成ではこれに代わって図3(c)に示している。ウエハロードロック室44の内部には、ホルダ45が設置されており、その上方にランプ46が配置されるようになっている。他の部分の構成はウエハローダ系第1の構成の場合と全く同じである。

【0023】次に本発明による装置のウエハローダ系第3の構成について図3(a)、(e)を利用して説明する。図3(e)は、ウエハローダ系第3の構成による、プリアライナb53の内部には、ホルダ60が設置されており、その上方にランプ62が配置されるようになっている。他の部分の構成はウエハローダ系第1または2の構成の場合と全く同じである。

【0024】次に、本発明によってレチクルが露光装置本体真空領域内に搬送されるまでの搬送形態の例を図1、図2を用いて説明する。先ず、レチクル大気圧ロボットアーム25がレチクルカセット22内に収納されているレチクル21を取り出し、レチクルプリアライナ23に搬入する。レチクルプリアライナ23内に置かれたレチクル21は所定の工程により、所定の位置・向きに揃えられる。その後、ゲートバルブa28が開き、レチクル大気圧ロボットアーム25は、レチクル21をレチクルロードロック室24内に搬送する。その後、ゲートバルブa28は閉じられる。

【0025】ここで、レチクルローダ系第1の構成の場合では、レチクル21はヒータ付き保温部材27上に搬送される。ヒータ付き保温部材27は、レチクルの温度よりも数℃ほど高い温度に設定されているため、レチクル21は加熱され、レチクル21の温度は上昇する。

【0026】レチクルローダ系第2の構成の場合では、レチクル21はホルダ34の上に搬送される。この状態で、レチクル21の上方にあるランプ26が照射され、レチクル21は加熱され、レチクル21の温度は上昇する。【0027】以後の搬送形態では、レチクルローダ系第1、2の構成で共通となっている。レチクル21に熱が加えられた後、真空ポンプ(図示せず)により、レチクルロ

ードロック室24の真空排気を行う。この段階で、レチクルロードロック室24の雰囲気温度は下がるが、レチクル21の温度は加熱されているため、雰囲気温度のようには下がらない。

【0028】所定の真空度に達した後、ゲートバルブ b 29 が開く。次に、レチクル真空ロボットアーム32がレチクル21を保持する。ゲートバルブ c 30が開き、レチクルステージチャンバ6内のレチクルホルグ5上に置かれる。この時、レチクル21の温度は、断熱膨張による雰囲気温度の低下による冷却と加熱とで相殺されており、ほぼ、断熱膨張で冷却される以前の温度となっている。そのため、レチクル真空ロボットアーム32でレチクル21がレチクルホルグ5上に搬送された後、レチクル温度が再び上昇するのを待つことなく、直に露光することができる。

【0029】上記レチクル搬送系第1の構成では、レチクル をヒータ付き保温部材27に接触させて加熱させ、上記 レチクル搬送系第2の構成では、ランプ26の照射によ り加熱させたが、加熱手段はこれらだけに限定されるも のではなく、他の加熱手段を使用しても構わない。ま た、加熱する時の加熱手段は一つだけを使うのに限るの で無く、同時に複数の加熱手段で加熱しても構わない。 【0030】次に、本発明によってウエハが搬送されるまで の搬送形態の例を図1、図3を用いて説明する。先ず、 ウエハ大気圧ロボット58がウエハカセット42内に収 納されているウエハ41を取り出し、ウエハプリアライ ナa43に搬入する。ウエハプリアライナa43内に置 かれたウエハ41は所定の工程により、所定の位置・向 きに揃えられる。その後ゲートバルブd47が開き、ウ エハ41はローダ大気圧ロボット58により、ウエハロ ードロック室44内に搬送される。

【0031】ここで、前記ウエハローダ系第1の構成では、ウエハ41はヒータ付き保温部材59上に搬送され、その後、ゲートバルブ d 47は閉められる。ヒータ付き保温部材59からウエハ41に熱が伝わり、これにより、ウエハ41は加熱され、ウエハ41の温度は上昇する。【0032】前記ウエハローダ系第2の構成では、ウエハ41はホルダ45上に搬送され、その後、ゲートバルブ d 47は閉められる。ウエハ41上のランプ46が照射され、これにより、ウエハ41は加熱され、ウエハ41の温度は上昇する。以後の搬送形態では、前記ウエハローダ系第1及び第2の構成で共通となっている。

【0033】ウエハ41に熱が加えられた後、真空ポンプ (図示せず)により、ウエハロードロック室44の真空 排気を行う。この段階で、ウエハロードロック室44の 雰囲気温度は下がるが、ウエハ41の温度は加熱されているため、雰囲気温度のようには下がらない。

【0034】所定の真空度に達した後、ゲートバルブ e 48 及びゲートバルブ g 5 0 が開く。ここで、ウエハ4 1 は ウエハ真空ロボットアームにより、ウエハロードロック 室44からウエハプリアライナb53内へ搬送される。 【0035】ここで、前記ウエハローダ系第1の構成では、 ウエハ41は恒温部材54上に搬送される。恒温部材5 4は内蔵のペルチェ素子56とヒータ55と温度計測センサ57により、精密に温度制御されているため、恒温 部材54に接触して置かれているウエハ41は精密に温度制御されることになる。

【0036】他方、前記ウエハローダ系第3の構成では、ウエハ41はホルダ60上に搬送される。ホルダ60は上方のランプ62に照射され、同時に温度計測センサ61により、精密に温度制御されているため、ホルダ60に接触して置かれているウエハ41も精密に温度制御されることになる。以下の搬送形態では、前記ウエハローダ系第1、第2及び第3の構成で共通となっている。

【0037】ウエハプリアライナb53内において、精密に 温度制御された状態で、ウエハ41は再度所定の工程に より、所定の位置・向きに正確に揃えられる。その後、 ウエハ真空ロボットアーム52によりウエハステージチ ャンバ6内のウエハホルダ8上に置かれる。この時、ウ エハ41の温度は、ロードロック室44では、断熱膨張 による雰囲気温度の低下による冷却は、加熱とで相殺さ れており、更に、プリアライナb53では、精密な温度 制御により、断熱膨張で冷却される前の温度となるよう に、微調整をしたため、ウエハの温度の安定化が図られ ている。そのため、プリアライナb53での温度の微調 整を終えた段階でのウエハ41の温度はほぼ所望の温度 となっている。従って、ウエハ真空ロボットアーム52 でウエハ41がウエハホルダ8上に搬送された後、ウエ ハの温度が安定するまでほとんど待つことなく、直に露 光することができる。

#### 【0038】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のうち請求項1に係わる発明においては、断熱膨張によるレチクルの温度低下が著しく少なくなるため、レチクルがレチクルステージチャンバに搬送されてからの温度が安定するまでの時間が非常に短くなり、高スループットで転写露光ができ、同時に、高精度で転写露光することができる露光装置を提供することができる。

【0039】本発明のうち請求項2に係わる発明においては、断熱膨張によるレチクルの温度低下をほぼ相殺することができるようになり、レチクルがレチクルステージチャンバに搬送されてからの温度が安定するまでの時間が非常に短くすることができる。

【0040】本発明のうち請求項3,4に係わる発明においては、簡単な手段で、レチクルに効果的に熱を伝えることができる。

【0041】本発明のうち請求項5に係わる発明においては、真空断熱によるウエハの温度低下が著しく少なくなるため、ウエハがウエハステージチャンバに搬送されてからの温度が安定するまでの時間が非常に短くなり、高

スループットで転写露光ができ、同時に、高精度で転写 露光することができる露光装置を提供することができ る。

【0042】本発明のうち請求項6に係わる発明においては、断熱膨張によるウエハの温度低下をほぼ相殺することができるようになり、ウエハがウエハステージチャンバに搬送されてからの温度が安定するまでの時間が非常に短くすることができる。

【0043】本発明のうち請求項7に係わる発明においては、ウエハの温度を精密に制御することができ、高スループットかつ高精度の露光装置を提供できる。

【0044】本発明のうち請求項8,9に係わる発明においては、簡単な手段で、ウエハに効果的に熱を伝えることができる。

【0045】本発明のうち請求項10,11に係わる発明においては、ウエハの温度を精密に制御することができ、高スループットかつ高精度の露光装置を提供できる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による露光装置の全体図である。

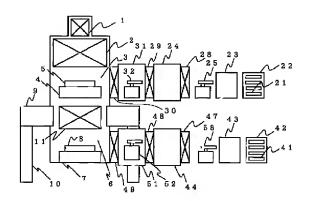
【図2】本発明によるレチクルローダ系を示す図であ る

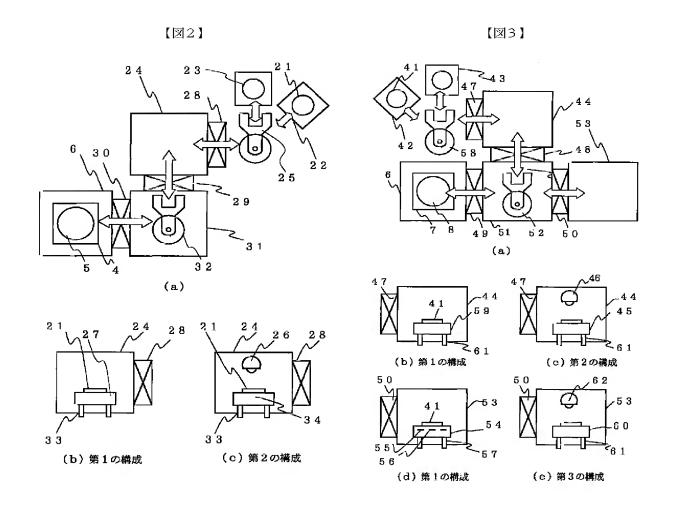
【図3】本発明によるウエハローダ系を示す図である。 【符号の説明】

- 1 電子銃
- 2 照明電子光学系
- 3 レチクルステージチャンバ
- 4 レチクルステージ
- 5 レチクルホルダ
- 6 ウエハステージチャンバ
- 7 ウエハステージ
- 8 ウエハホルダ
- 9 メインボディ
- 10 脚
- 11 投影光学系
- 21 レチクル

- 22 レチクルカセット
- 23 レチクルプリアライナ
- 24 レチクルロードロック室
- 25 レチクル大気圧ロボットアーム
- 26 ランプ
- 27 ヒータ付き保温部材
- 28 ゲートバルブa
- 29 ゲートバルブb
- 30 ゲートバルブc
- 31 レチクル真空ロードチャンバ
- 32 レチクル真空ロボットアーム
- 33 温度計測センサ
- 34 ホルダ
- 41 ウエハ
- 42 ウエハカセット
- 43 ウエハプリアライナa
- 44 ウエハロードロック室
- 45 ホルダ
- 46 ランプ
- 47 ゲートバルブ d
- 48 ゲートバルブe
- 49 ゲートバルブ f
- 50 ゲートバルブg
- 51 ウエハ真空ロードチャンバ
- 52 ウエハ真空ロボットアーム
- 53 ウエハプリアライナb
- 54 恒温部材
- 55 ヒータ
- 56 ペルチェ素子
- 57 温度計測センサ
- 58 ウエハ大気圧ロボット
- 59 ヒータ付き保温部材
- 60 ホルダ
- 61 温度計測センサ
- 62 ランプ

## 【図1】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FI HO1L 21/30

531M 551 (参考)